

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Typ	Works With	Množství v balení	Hloubka	Šířka
------------------	-----	------------	-------------------	---------	-------

24830-005	Heat Conductor	Cases	1	22 mm	22 mm
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte